

Plaskon S-7PG

Еpoxy; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is a low stress, low viscosity epoxy encapsulant designed for packaging stress-sensitive semiconductor devices. It is specifically formulated to provide a lower viscosity for those low stress applications where wire sweep may be a concern. It offers end users superior value-in-use due to a balanced mix of properties.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Низкая вязкость Лазерная маркировка Хорошая производительность формования Отличный внешний вид		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.84	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.47	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	0.00637	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1.31	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (21°C)	0.0107	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	170	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.8E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	16	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	5.5E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	16	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	3.60		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	4.0E-3		ASTM D150
Дуговое сопротивление	180	sec	ASTM D495
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	32	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Recommended Storage Temperature: 5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 5 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 60 to 90 cm Automatic Orifice Viscosity, 175°C, 1000 psi, 1 mm die length, 1/2 mm diameter: 9 Pascal sec Ram Follower Gel Time, 177°C: 10 to 18 sec Ash Content: 73.7 % Hydrolyzable Halides: <1 ppm Cull Hot Hardness, Shore D, 90 sec, 175°C: 70 Arc Resistance, 110v AC 180 sec All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 18 cm⁻⁶/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 65 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Preheat Temperature: 85 to 95°C

Molding Temperature: 170 to 185°C

Molding Pressure: 900 to 1200 psi

Cure Time, 177°C: 1 to 2 min

Post Mold Cure Time, 175°C: 4 to 12 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat